证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2022-008

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会议于2022年2月21日以通讯的方式召开。本次董事会已于2022年2月15日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、同意《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2022-009。

关联董事陈向东、范伟宏、王汇联、汤树军回避表决。表决结果:以8票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

二、同意《关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2022-010。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

三、同意《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2022-011。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022年2月22日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2022-009

杭州士兰微电子股份有限公司关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:厦门士兰集科微电子有限公司

●投资金额:本公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司以货币方式共同出资885,000,000元认缴士兰集科本次新增注册资本827,463,681元。

●本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次交易需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

(一)杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")参股公司厦门士兰集科微电子有限公司(以下简称"士兰集科")拟新增注册资本827,463,681元。本公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称"大基金二期")以货币方式共同出资885,000,000元认缴士兰集科本次新增的全部注册资本,其中:本公司出资285,000,000元认缴新增注册资本266,471,355元;大基金二期出资600,000,000元认缴新增注册资本560,992,326元。本次增资溢价部分计入士兰集科的资本公积。士兰集科另一方股东厦门半导体投资集团有限公司(以下简称"厦门半导体")放弃优先认购权。本次增资完成后,士兰集科的注册资本将由3,000,490,000元增加为3,827,953,681元。

本次增资完成前后,士兰集科的股权结构如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	256,041.65	85	256,041.65	66.828
2	杭州士兰微电子股份有限公司	45,007.35	15	71,654.4855	18.719
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	-	56,099.2226	14.655
合计		300,049.00	100	382,795.3681	100

(二)本公司拟与大基金二期、厦门半导体及士兰集科签署与本次增资相关的《增资协议》。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成上市公司的关联交易。

(五)本次关联交易需提交股东大会审议。在获得股东大会审议通过的前提下,公司提请授权董事长陈向东先生签订与本次投资有关的协议。

(六)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(七)本次交易尚需获得大基金二期、厦门半导体和士兰集科等各方内部权力机构批准。

二、投资标的暨关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,士兰集科为本公司的关联法人。本次交易构成上市公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

1、名称:厦门士兰集科微电子有限公司

2、类型:法人商事主体(其他有限责任公司)

3、住所:厦门市海沧区兰英路89号

4、法定代表人:王汇联

5、注册资本:叁拾亿零肆拾玖万元整

6、成立日期:2018年2月1日

7、营业期限:2018年2月1日至2068年1月31日

8、经营范围:集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。

9、股东情况:

序号	股东	认缴注册资本(万元)	出资形式	持股比例(%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	256,041.65	货币	85
2	杭州士兰微电子股份有限公司	45,007.35	货币	15
合计		300,049.00	——	100

以上所有股东的出资均已全部实缴到位。

10、财务情况:截止2020年12月31日,士兰集科经审计的总资产为382,247万元,负债为138,299万元,净资产为243,948万元。2020年度净利润为-3,833万元。士兰集科2020年尚处于建设期,未有主营业务收入。

截止2021年9月30日,士兰集科未经审计的总资产为572,846万元,负债为340,829万元,净资产为232,017万元。2021年1-9月营业收入为43,257万元,净利润为-11,931万元。

三、投资方式及共同投资方暨关联方介绍

(一)投资方式

士兰集科本次拟新增注册资本827,463,681元。本次增资每1元注册资本对应的增资款为1.069533347元,即士兰集科本次新增注册资本827,463,681元对应的增资款为885,000,000元。本公司拟与大基金二期以货币方式共同出资885,000,000元认缴士兰集科本次新增的全部注册资本,其中:本公司出资285,000,000元认缴新增注册资本266,471,355元;大基金二期出资600,000,000元认缴新增注册资本560,992,326元。本次增资溢价部分计入士兰集科的资本公积。士兰集科另一方股东厦门半导体放弃优先认购权。本次增资完成后,士兰集科的注册资本将由3,000,490,000元增加为3,827,953,681元。

本次增资完成前后,士兰集科的股权结构如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	256,041.65	85	256,041.65	66.828
2	杭州士兰微电子股份有限公司	45,007.35	15	71,654.4855	18.719
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	-	56,099.2226	14.655
合计		300,049.00	100	382,795.3681	100

(二)共同投资方的基本情况

1、公司名称:国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

2、成立时间:2019年10月22日

3、注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6

4、注册资本:20,415,000万元

5、法定代表人:楼宇光

6、公司类型:其他股份有限公司(非上市)

7、经营范围:项目投资、股权投资;投资管理、企业管理;投资咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

8、股东情况:其第一大股东为财政部(持有11.02131%),其余主要股东为国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、上海国盛(集团)有限公司等。

9、关联关系介绍:公司董事汤树军先生系公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董事。国家集成电路产业投资基金股份有限公司的法定代表人和部分董事、监事、高级管理人员以及部分主要股东与大基金二期均相同。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,大基金二期为上市公司的关联方,汤树军先生为关联董事需回避表决。

四、增资协议的主要内容

(一)协议各方

1、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司("大基金二期")

2、厦门半导体投资集团有限公司("厦门半导体")

3、杭州士兰微电子股份有限公司("士兰微")

4、厦门士兰集科微电子有限公司("士兰集科")

(二)增资方案

士兰集科同意根据本协议的条款和条件,将其注册资本由3,000,490,000元增加至3,827,953,681元,新增注册资本由认购方认缴。认购方同意根据本协议的条款和条件,由大基金二期出资人民币600,000,000元("大基金二期增资价款")、士兰微出资人民币285,000,000元("士兰微增资价款")、合计出资人民币885,000,000元("增资价款")认缴士兰集科新增注册资本("本次增资"),其中人民币827,463,681元应计入士兰集科的注册资本,人民币57,536,319元作为溢价进入士兰集科的资本公积金。增资价款将用于24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目。厦门半导体就大基金二期和士兰微认缴士兰集科新增注册资本特此放弃行使士兰集科章程、其他任何行使的法律文件以及相应中国法律规定的,其对大基金二期认缴士兰集科新增注册资本的优先认购权,并确保不存在其他拥有优先认购权的人士或实体,或该等人士或实体已经适当放弃行使该等优先认购权。

本次增资完成后,各方对士兰集科的股权比例如下表所示:

序号	股东名称	认缴注册资本(元)	持股比例(%)
1.	厦门半导体	2,560,416,500	66.828
2.	士兰微	716,544,855	18.719
3.	大基金二期	560,992,326	14.655
合计		3,827,953,681	100.00

(三)大基金二期增资先决条件

大基金二期在交割日支付大基金二期增资价款的义务取决于下列先决条件的实现或被大基金二期书面豁免(如适用):

1、士兰集科和原有股东已经签署并向大基金二期交付各项交易文件,该等交易文件于交割日维持完全有效;

2、士兰微已向士兰集科全额支付士兰微增资价款且向大基金二期提供实际出资的银行汇款凭证复印件;

3、士兰集科已就本次增资取得国家开发银行厦门分行的书面同意;

4、士兰集科已就本次增资取得所有政府批准,该等政府批准在交割日维持完全有效且未实质修改交易文件的约定;

5、没有政府机构制定、发布、颁布、实施或通过任何使本协议项下的交易违法或限制/阻止该等交易完成的法律或政府法令(无论是临时的、初始的或是永久的);

6、截至交割日,士兰集科和原有股东在本协议中作出的陈述和保证在所有方面均是真实和准确的;

7、自本协议签署日直至交割日(包括交割当日),未发生任何对士兰集科造成重大不利影响的情形;

8、士兰集科在所有重大方面已履行和遵守交易文件要求其在交割日或之前履行或遵守的所有约定与承诺;

9、2021年11月26日签署的《厦门士兰集科微电子有限公司增资协议之补充协议》的内容未发生变更;

10、士兰集科就本次增资取得市场监督管理局出具的(a)由市场监督管理局就本次增资和士兰集科章程出具的审批或备案文件;(b)由市场监督管理局向士兰集科颁发的、反映本次增资的《营业执照》;(c)市场监督管理局向士兰集科出具的有关本次增资、士兰集科章程的登记证明;以及(d)市场监督管理局向士兰集科出具的就各方按照《增资协议》和士兰集科章程的规定委派的所有董事、监事完成备案的备案证明。

当所有交割条件已得到实现(或已被有权豁免该等条件的一方书面豁免)后,士兰集科应向大基金二期发出书面通知("先决条件成就通知"),确认上述各项先决条件均已实现,并附上上述所述全部先决条件成就的证明文件。大基金二期本次增资应当于公司向大基金二期送达先决条件成就通知后第二十(20)个工作日内或各方经协商一致另行书面约定的其他日期("交割日")完成("交割")。

(四)公司治理

1、士兰集科将依据《公司法》以及公司章程建立公司法人治理结构,股东会为公司最高权力机构。

士兰集科设立董事会,董事会由6名董事组成。其中,厦门半导体提名1名董事,士兰微提名3名董事,大基金二期提名1名董事。董事长为公司法定代表人,董事长由董事会选举产生。

士兰集科设立监事会,监事会成员共5名,其中厦门半导体提名1名监事,士兰微提名1名监事,大基金二期提名1名监事,职工监事2名。

公司设立董事会领导下的以总经理为首的经营管理团队,管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员,由董事会聘任或解聘。

2、股东会决策机制

各方同意有关士兰集科下列事项的决定需经代表三分之二以上表决权的股东表决同意方为有效:

(1)修改公司章程;

(2)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(3)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(4)决定公司的经营方针和投资计划;

(5)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(8)对公司发行公司债券作出决议;

(9)审议公司重要对外投资(认定标准为对同一项目或企业累计投资金额超过人民币1,000万元的情况);

(10)对公司的业务范围和/或主营业务方向发生重大改变、从事主营业务以外的业务作出决议;

(11)审议批准公司为股东或实际控制人提供担保或为除股东或实际控制人以外任意第三方提供大于100万元人民币的担保;

(12)审议批准公司知识产权、商标、土地使用权、房产等重大资产的处置(认定标准为评估价值人民币5,000万元以上的土地、房产、知识产权等资产);

(13)审议批准公司的上市计划,包括中介机构(券商、保荐代表、会计师事务所、律师事务所)的聘用、上市主体、上市时间、地点、价格等;

(14)审议批准订立任何投机性的互换、期货或期权交易,进行委托理财、委托贷款事项;

(15)审议批准公司的重大资产重组(认定标准为任何与公司相关的、评估价值超过上一年经审计的公司净资产30%的资产控制权发生变更的事项);

(16)审议批准单笔金额5,000万元以上或累计占公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上的关联交易;

(17)制定股权激励计划;

(18)批准公司的股权转让、质押;

(19)改变公司董事会人数;

(20)制定或改变董事会议事规则;

(21)审批批准董事会的报告;

(22)审批批准监事会的报告;

(23)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应由股东会决定的其他事项。

涉及前述(1)至(4)项,(10)项及(17)至(20)项的修改或决议或决定,需经股东一致同意方可通过。

3、董事会决策机制

士兰集科下列重要事宜需要经全体董事一致同意方可通过:

(1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;

(2)执行股东会的决议;

(3)决定公司的经营计划和投资方案;

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(8)决定公司内部管理机构的设置;

(9)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(10)制定公司的基本管理制度;

(11)审议批准单笔金额5,000万元以下或累计占公司最近一期经审计净资产绝对值低于20%的关联交易;

(12)审议批准公司知识产权、商标、土地使用权、房产等资产的处置(认定标准为评估价值人民币5,000万元以下的土地、房产、知识产权等资产);

(13)审议公司有关重大诉讼、仲裁(即涉案金额达到或超过2,000万元以上)的和解方案;

(14)法律、法规或公司章程规定,以及股东会授予的其他职权。

4、共担风险

在厦门半导体、士兰微和大基金二期持有士兰集科股权期间,各方按照各自的持股比例,分享士兰集科经营成果,分担士兰集科经营风险。

(五)股权转让和增资

厦门半导体持有的士兰集科股权根据本协议第6.16条之约定被士兰微收购完成之前,未经厦门半导体以书面形式同意,士兰微不得向任意第三方转让股权;未经士兰微以书面形式同意,厦门半导体亦不得向任意第三方转让股权;本协议另有约定的除外。为免疑义,本条所述的股权转让包括但不限于以协议方式而不办理工商变更登记的转让。

本次增资交割后,在不违反本协议有关约定的情况下,如果士兰微拟向厦门半导体和大基金二期以外的其他受让方出售其所持有士兰集科的股权且厦门半导体和大基金二期未行使第6.11条约定的"优先受让权",则厦门半导体和大基金二期均有权以与士兰微拟向受让方转让股权相同的价格、条款和条件,按照厦门半导体和大基金二期与转让方之间的相对持股比例向受让方出售厦门半导体和大基金二期持有的部分或全部士兰集科股权,且士兰微应有义务促使受让方以该等价格、条款和条件购买厦门半导体和大基金二期所持有的士兰集科股权。若受让方不接受大基金二期向其转让股权,则转让方不得向受让方转让股权。

本次增资交割后,除本协议另有约定外,若士兰集科拟进行任何增资,该等增资每1元注册资本的认购价格不得低于大基金二期本次增资中获得士兰集科每1元注册资本的认购价格且不得低于届时经备案的资产评估值。

除本协议另有约定外,若士兰集科给予其他任何股东或新的投资人的权利优于大基金二期的权利,则大基金二期有权无需另行支付任何对价即可自动享有该等更优惠的权利,确保大基金二期的权利应优先于或至少相当于所有其他股东(包括随后的各轮融资的投资人)的权利。

(六)受让与收购

各方同意,原有股东于2021年11月26日签署的《厦门士兰集科微电子有限公司增资协议之补充协议》特此通过援引而被纳入本协议,为本协议的一部分,如同各方在本协议中同意继续履行该条款。自本协议签署日起,如需调整前述《厦门士兰集科微电子有限公司增资协议之补充协议》,各方协商一致方能修改。

(七)违约责任

如果士兰集科违反本协议中的陈述、保证、承诺或义务(包括但不限于公司未披露的交割日前任何期间的负债(包括或有负债)),导致大基金二期遭受损失(包括损害、责任、权利请求、诉讼、费用和支出,统称"损失"),士兰集科应向大基金二期赔偿该等损失。在由士兰集科对大基金二期进行赔偿的情形下,赔偿金额应按照如下公式进行计算:赔偿金额 = 损失金额 -(1?大基金二期届时持有的公司股权比例),以确保大基金二期不会因公司履行本第10.1.1款下的赔偿义务而承担任何间接损失。

如果士兰微或厦门半导体违反本协议中的陈述、保证、承诺或义务,导致大基金二期遭受损失,则士兰微或厦门半导体应向大基金二期赔偿该等损失。

如果大基金二期违反本协议中的陈述、保证、承诺或义务,导致士兰集科或士兰微或厦门半导体产生损失,大基金二期应当向士兰集科或士兰微或厦门半导体进行赔偿。

(八)争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应首先争取通过友好协商解决。协商不成的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会("仲裁机构"),按照申请仲裁时仲裁机构现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

(九)协议的生效

本协议自各方盖章并由授权代表签字之日起成立并生效。

五、投资事项对上市公司的影响

士兰集科为本公司与厦门半导体根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司。士兰集科已于2021年5月启动了第一条12吋集成电路芯片生产线(以下简称"12吋线")之"新增年产 24 万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目"。本次增资的主要目的是为了进一步增加士兰集科的资本充足率,加快推动12吋线的建设和运营,有利于士兰集科产能提升,为本公司提供产能保障,对本公司的经营发展具有长期促进作用。

六、投资的风险分析及对策

12吋线的建设具有资本投入大、资产属性重、技术壁垒高、建设达产周期长的特点。为持续保证竞争力,士兰集科需要在产品研发、制造工艺研发、设备更新维护、人才梯队培养等各个环节上持续进行资金的投入。同时士兰集科12吋线在逐步达产过程中也会受到市场外部环境变化等因素的影响,可能会对产线效益的整体发挥产生不利影响。

公司一方面控制投资节奏,及时规避和有效解决12吋线在建设和运营过程中可能出现的问题;另一方面积极把握扩产时机,争取加快建设,帮助和配合士兰集科不断加强内部管理,提升工艺技术水平,持续开发新产品,进一步拓展销售渠道,努力提升经济效益,增强抗风险能力。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事事前认可情况:独立董事对公司拟提交第七届董事会第三十二次会议审议的《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案》进行了事前审查。经审查,全体独立董事一致认为:本次拟提交董事会审议的有关关联交易的议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,对公司的经营发展有一定的促进作用,符合全体股东的利益,同意提交董事会审议。

(二)公司第七届董事会第三十二次会议于2022年2月21日召开,会议审议通过了《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案》。关联董事陈向东、范伟宏、王汇联、汤树军依法回避了表决。

(三)独立董事发表独立意见如下:

1、公司本次与大基金二期共同向关联企业士兰集科增资的主要目的是为了提升士兰集科的资本充足率,加快推动12吋集成电路芯片生产线的建设和运营。本次交易符合公司发展战略规划,对公司主营业务发展具有长期促进作用,符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事已回避对上述议案的表决。

3、本次增资的方式及定价遵循双方自愿协商、公平合理的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司本次与大基金二期共同向关联企业士兰集科增资并签署协议的事项,并提交公司股东大会审议。

(四)本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经大基金二期、厦门半导体和士兰集科等各方内部权力机构批准后方可正式实施。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

八、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明。

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022年2月22日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2022-010

杭州士兰微电子股份有限公司关于对控股子公司成都集佳提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:成都集佳科技有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本公司和控股子公司成都士兰半导体制造有限公司本次拟为成都集佳科技有限公司3.5亿元项目融资贷款提供担保。截至本公告披露日,公司为其实际提供的担保余额为1.64亿元。

● 本次担保无反担保

● 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

本公司之控股子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称"成都士兰")之全资子公司成都集佳科技有限公司(以下简称"成都集佳")拟向中国农业银行股份有限公司金堂县支行申请项目融资贷款3.5亿元,用于"汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期"项目建设,贷款期限9年。本公司和成都士兰拟为成都集佳该笔贷款提供担保,其中:成都士兰以其自有的国有土地使用权及地上已取证的9栋建筑物作为抵押物为其1.37亿元贷款本金及利息等费用提供抵押担保,本公司为其2.13亿元贷款本金及利息等费用提供全程全额连带责任保证担保。

2022年2月21日,公司召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:成都集佳科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、成立时间:2015年6月2日

4、注册地址:四川省成都市金堂县淮口镇士芯路9号1栋1-3楼(成都一阿坝工业集中发展区内)

5、注册资本:65,000万元

6、法定代表人:范伟宏

7、营业期限:2015年6月4日至长期

8、经营范围:集成电路、半导体分立器件、功率模块等半导体产品的设计、制造、销售及相关技术转让;相关的原材料、机械设备的销售;货物进出口和技术进出口。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、股东情况:公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司持有其100%股权,公司间接持有其70%的股权。

10、财务情况:截至2020年12月31日,成都集佳经审计的总资产为54,766万元,负债为15,762万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额15,095万元),净资产为39,004万元。2020年营业收入为38,736万元,净利润为2,591万元。

截至2021年9月30日,成都集佳未经审计的总资产为91,779万元,负债为38,338万元(其中银行贷款总额5,000万元,流动负债总额26,410万元),净资产为53,441万元。2021年1-9月营业收入为47,809万元,净利润为2,437万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司股东大会审议,尚未签订具体担保协议。董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下,授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、董事会意见

2022年2月21日,公司召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。董事会认为:成都集佳为公司在成都-阿坝工业集中发展区投资成立的专业从事半导体功率器件和功率模块、新型集成电路封装与测试的高新技术企业。本次担保有利于成都集佳获得银行的长期项目贷款,为"汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期"的建设和运营提供资金保障,有利于扩充其封装产能,提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势,对公司的经营发展具有长期的促进作用。

五、公司担保情况

截至2022年2月21日,公司合计担保余额为31.48亿元,占公司最近一期经审计净资产的91.30%,其中:公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币22.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的65.55%;公司向其它第三方提供担保的余额为8.88亿元(公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保余额为6.12亿元,公司为厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保余额为2.76亿元),占公司最近一期经审计净资产的25.75%。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

六、上网公告附件

被担保人成都集佳的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022年2月22日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　公告编号:临2022-011

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年3月9日14点00分

召开地点:浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年3月9日

至2022年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案	√
2	关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年2月21日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。会议决议公告已于2022年2月22日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:陈向东、范伟宏、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、厦门半导体投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2022/3/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记,须在登记时间2022年3月7日下午16:00前送达,传真、信函或电子邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号三楼投资管理部

(三)登记时间:2022年3月7日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

(四)联系方式:

联系人:马先生、陆女士

联系电话:0571-88212980

传真:0571-88210763

电子邮箱:ml@silan.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022年2月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案			
2	关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人或受托人联系方式(电话):

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2022-004

浙江春风动力股份有限公司监事集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●监事持股的基本情况

本次减持计划实施前,浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")监事金顺清持有公司股份608,128股,占公司总股本比例为0.41%。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2021年11月2日披露了《浙江春风动力股份有限公司监事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-114),监事金顺清计划以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过150,000股,占公司总股本的0.10%,占其持有股份的24.67%,减持价格按市场价格确定。

近日,公司收到监事金顺清先生的通知,截至2022年2月19日,本次减持计划时间已过半,金顺清先生未减持公司股份,减持计划尚未实施完毕。具体情况如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
金顺清	董事、监事、高级管理人员	608,128	0.41%	IPO前取得:608,128股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)监事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
金顺清	0	0%	2021/11/23 ~ 2022/2/19	集中竞价交易	0-0	0	608,128	0.41%

(二)本次减持事项与监事此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

金顺清不是公司的控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注监事金顺清减持股份计划的后续进展实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

截至目前,本次减持计划尚未实施完毕。金顺清后续将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施本次减持计划。减持时间、减持价格存在不确定性风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次股东减持不存在违反《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情况,不存在不得减持股份的情形。

公司将持续关注相关事项的后续进展情况,并督促股东及时、依法履行